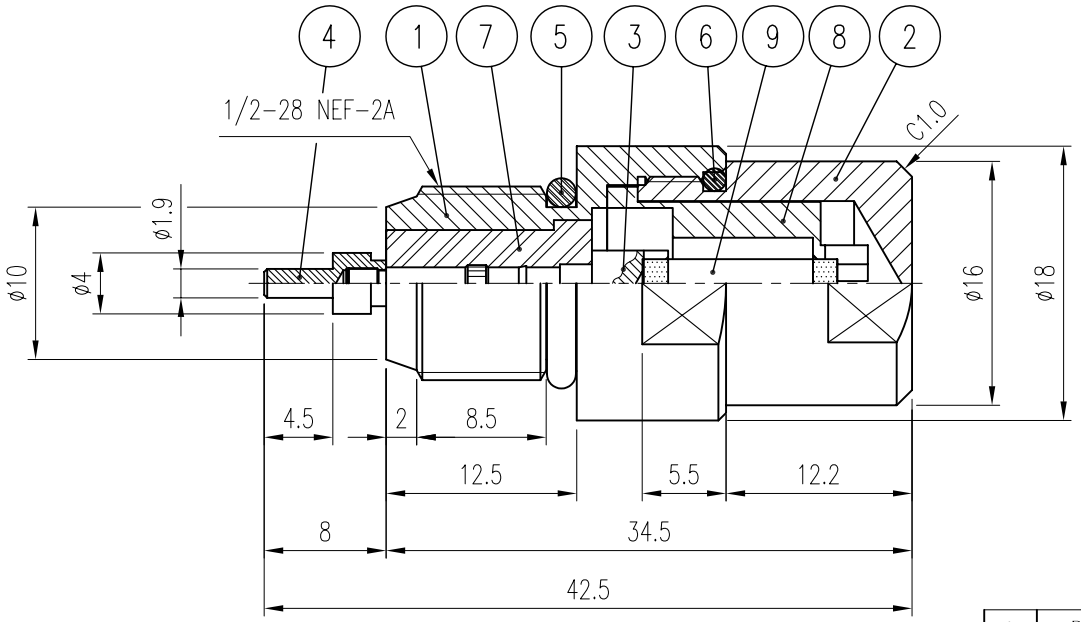
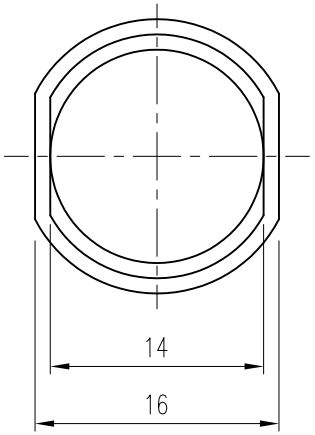
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	부적합 개선[설계처리 No.연구200806-0001] (나사 체결 부 길이 변경 BODY 코드 변경)	김은희	윤상진	2008. 06. 02.





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
9	RESISTOR	1	RES-NET	R125B500	DRE00058-N/1 (XA119)
8	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00093-5/1 (M8046)
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01279-5/1
6	GASKET	1	SILICONE RUB	S-12.5	DGK00186-N/1
5	GASKET	1	SILICONE RUB	P-10(9.8*1.9)	DGK00033-N/1 (G8037)
4	CONTACT (B)	1	MBsBD	Silver Plate(7㎛)	DCT01547-5/1
3	CONTACT (A)	1	MBsBD	Silver Plate	DCT01546-5/1
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02035-5/1 ~~DBD02023-5/1~~
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02022-5/1

< 주 기 >

1. 품번① BODY(A)와 품번②BODY(B) 나사 체결 시 LOCTITE 도포 할 것.
2. 품번③CONTACT(A)와 품번④CONTACT(B) 나사 체결 시 LOCTITE 도포 할 것.

대체가능재질	년월일	2008. 5. 20.	KJ COMTECH CO.,LTD.
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
재질	검도		도명 ENTRY TERM 25W VER.1
열처리	제도		
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 TM00023-7/2
	척도 2/1	단위 mm	중량